

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1512号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股18,421,053股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为921,052股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,250,001股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5,250,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年8月7日（T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年8月4日

（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司



2023年8月4日

（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司
2023年8月4日

